

The background of the slide features a blue gradient with abstract, glowing lines and squares in various colors (yellow, orange, purple). On the left side, there are images of industrial machinery, including a large metal frame and a yellow component.

先進設備科技 整合領航者 3413

京鼎精密科技

上市前業績發表會

公司介紹

報告人：劉應光 董事長

中華民國 104 年 7 月 8 日

免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司無法掌控之風險因素。

本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

本公司並未作任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本資料不構成證券發行邀約。

報告大綱

(一) 公司簡介

(二) 經營實績

(三) 市場概況及競爭優勢

(四) 產品實例

(五) 研發成果及未來發展計畫

公司名稱：京鼎精密科技股份有限公司

成立日期：2001年4月26日

資本額：新台幣6億元

董事長：劉應光 總經理：劉應光

營業項目：半導體及自動化等設備、模組及關鍵性零組件之研發、
製造及銷售

TAIWAN(2001)

京鼎精密科技股份有限公司
苗栗縣竹南鎮新竹科學園區



USA(2002)

Foxsemicon Integrated Technology Inc.
美國加州 San Jose, 德州 Austin.



CHINA(2005)

富士邁半導體精密工業(上海)
有限公司
中國上海市松江工業區



重要紀事

- 2015-05 通過臺灣證券交易所董事會上市審議。
- 2014-07 竹南廠與松江廠通過ISO13485認證，正式跨入醫療設備產業。
- 2013-12 榮獲世界第一大半導體設備製造商最佳品質及準時達交供應商評鑑獎。
- 2013-07 公司更名為京鼎精密科技股份有限公司。
- 2012-08 董事會決議結束公司先進光電事業群營運。
- 2012-04 榮獲符合經濟部工業局自動化技術服務機構服務能量作業登錄重點公司。
- 2011-07 公司更名為晶鼎能源科技股份有限公司。
- 2007-05 獲選為天下雜誌2006年臺灣1,000大製造業第578名，半導體產業中名列第57名。
- 2007-04 成立先進光電事業群，跨入LED照明產業。
- 2006-12 榮獲德勤2006年亞太地區高科技高成長500強第283名 (三年營收成長率為172.71%)。
- 2006-03 通過環境管理系統 ISO14001:2004 版認證。
- 2005-12 榮獲勤業眾信2005年亞太地區高科技高成長500強第72名。
- 2005-08 榮獲經濟部頒發93年度金貿獎出口成長率第九名。
- 2005-07 富士邁半導體精密工業(上海)有限公司正式量產。
- 2005-01 通過環境管理系統 ISO14001:1996 版認證。
- 2004-12 於證券櫃檯買賣中心興櫃掛牌。
- 2004-10 榮獲經濟部頒發第十二屆產業科技發展獎之優等獎。
- 2003-05 新廠落成，新竹科學工業園區科中廠新廠開工典禮。
- 2002-04 通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證。開始量產。
- 2002-02 成立美國分公司Foxsemicon Integrated Technology Inc.及子公司Foxsemicon LLC。
- 2001-12 「半導體製程設備及零組件」投資計畫獲經濟部工業局核准為新興重要策略性產業。
- 2001-04 沛鑫半導體工業股份有限公司設立，主要營業項目為半導體/平面顯示器設備、次系統及系統整合。

- 經營理念

品質—品質是做出的，不是檢驗而來的。

速度—我們於第一時間反應、處理並滿足客戶的需求。

成本—持續提升成本競爭力，以達到客戶與公司雙贏的目標。

彈性—憑藉積極應變的能力，馳騁少量多樣的市場。

服務—提供客戶全方位的產品與解決方案。

- 企業價值觀

正直誠信—我們相信正直誠信是公司立足的根本。

客戶導向—符合並超越客戶的要求、成為客戶不可或缺的事業夥伴。

創新研發—於產品、技術、流程及思考模式中，隨時注入不同觀點的思維。

承諾責任—永續經營是我們對員工、股東與社會的承諾。

104年3月26日

職稱	姓名	學經歷	現職
董事長	劉應光	私立華夏工專機械工程科 鴻海精密資深副總經理	京鼎精密科技董事長暨總經理 富士邁半導體精密董事長
董事	鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙	中央大學機械工程所碩士	鴻準精密工業董事 鴻富錦精密電子(鄭州)董事
董事	傅承祖	清華大學材料所博士 聯合技術學院副教授兼系主任	京鼎精密科技自動化事業處副總經理 新普科技董事
董事	黃榮慶	德國漢堡大學醫學博士 陽明大學泌尿學科兼任教授 國防醫學院外科學科兼任教授 高雄榮民總醫院院長	私立財團法人天主教聖功醫院顧問醫生
獨立董事	李康智	美國俄亥俄州辛辛那提大學材料學博士	中華開發工業銀行董事 台灣美日先進光罩總經理
獨立董事	陳錫智	文化大學會計研究所碩士	展岳聯合會計師事務所 執業會計師
獨立董事	傅正輝	輔仁大學金融所碩士	合庫證券經理

* 京鼎於103/6/25設立審計委員會取代監察人功能

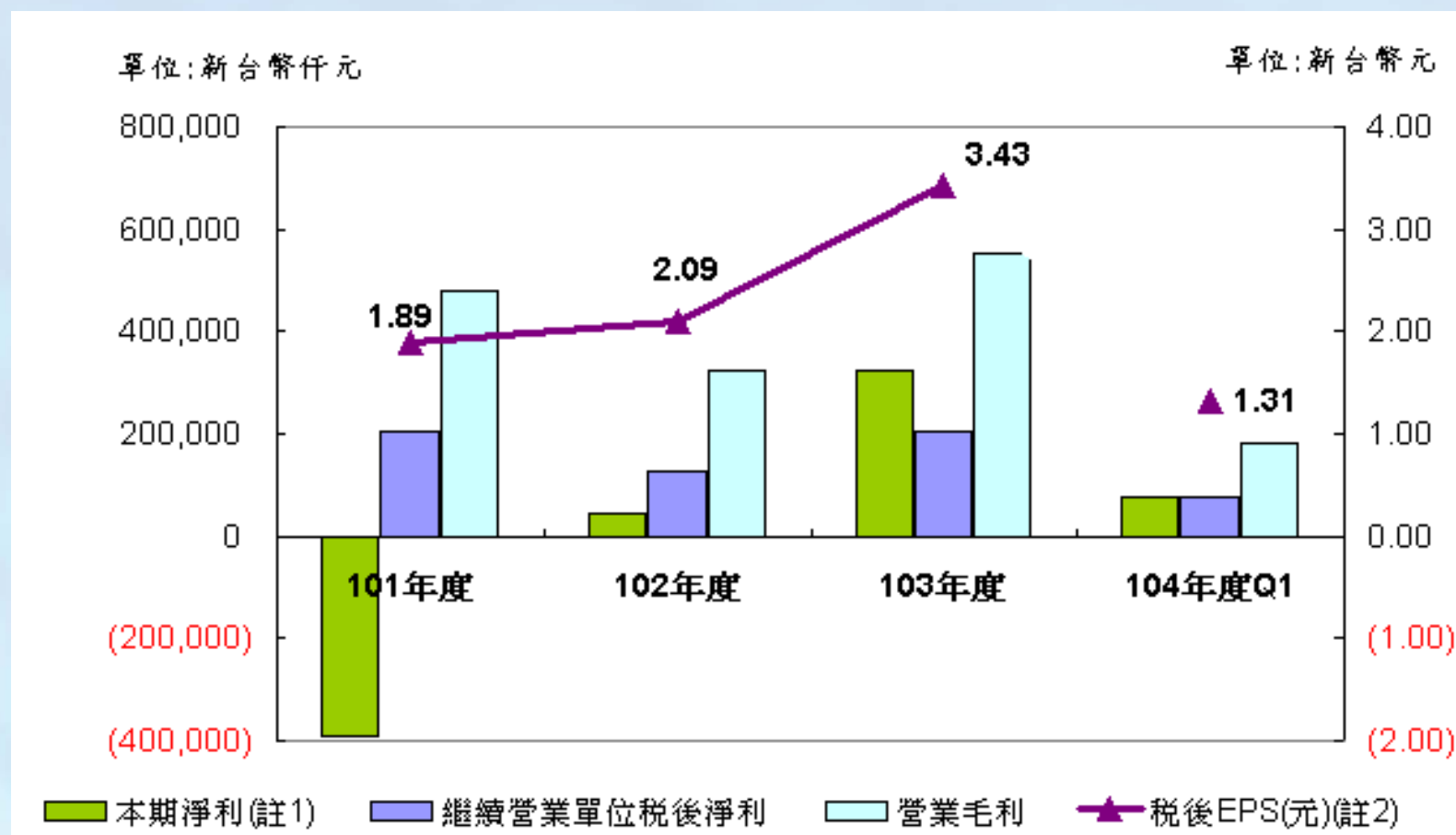
職稱	姓名	學歷	經歷	產業年資
總經理	劉應光	私立華夏工專機械工程科	鴻海精密 - 資深副總經理 京鼎精密科技股份有限公司 中國營運本部副總	30年
業務資深副總經理	黃啟智	UT. Austin Chemistry-Ph.D SWUT. San Marcos Computer Science - Master 台灣大學化學系	鐸德科技-董事長兼總經理 美商ASYST / PST - 行銷副總	25年
研發副總經理	傅承祖	清華大學材料所博士	新普科技董事 國立聯合技術學院 - 副教授/ 系主任	25年
總經理特助	陳鎮福	台灣大學EMBA 美國中央密蘇里州立大學企管所	金瑞治科技 - 顧問 喬鼎資訊 - 財務長 沛鑫能源科技 - 副總經理 台灣應用材料 - 主計長	30年
業務資深協理	邱耀銓	University of Nevada, Las Vegas EE	鐸德科技 - 經理 美商ASYST / PST - 經理	18年
財務資深經理	呂軍甫	香港中文大學EMBA 中山大學EMBA 東海大學工業工程所	富士康國際 - 資深副理 鴻準精密工業 - 副理 鴻海精密工業 - 專理	19年
會計經理	鍾曉佩	中華大學財務管理系	沛鑫半導體工業 佳邦科技	15年

單位：新台幣仟元

項 目	101年度 (IFRSs)	102年度 (IFRSs)	103年度 (IFRSs)	104年Q1 (IFRSs)
營業收入	2,679,903	2,468,753	4,602,925	1,002,340
營業毛利	479,818	323,419	554,701	182,466
營業費用	277,799	257,827	401,591	100,327
營業淨利	202,019	65,592	153,110	82,139
營業外收入及支出	28,297	70,643	59,858	(7,752)
所得稅費用	26,905	11,011	6,909	(4,079)
本期淨利(註1)	(389,008)	42,871	323,079	78,466
繼續營業單位稅後淨利	203,411	125,224	206,059	78,466
稅後EPS(元)(註2)	1.89	2.09	3.43	1.31

註1：包含繼續營業單位及停業單位損益

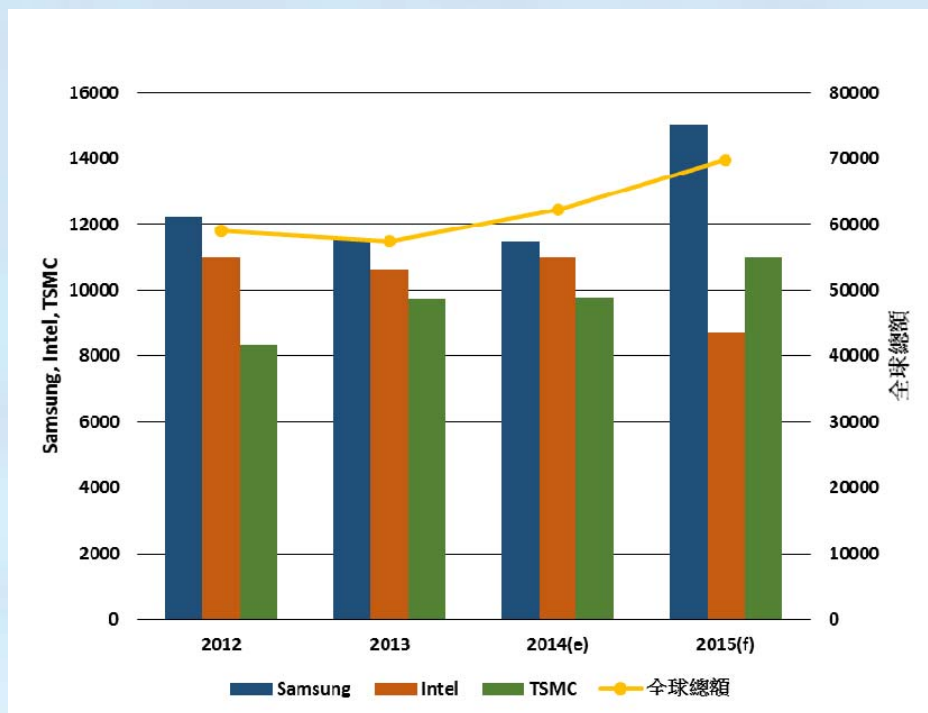
註2：係採用繼續營業單位稅後淨利及當期期末股數計算之EPS



註1：包含繼續營業單位及停業單位損益

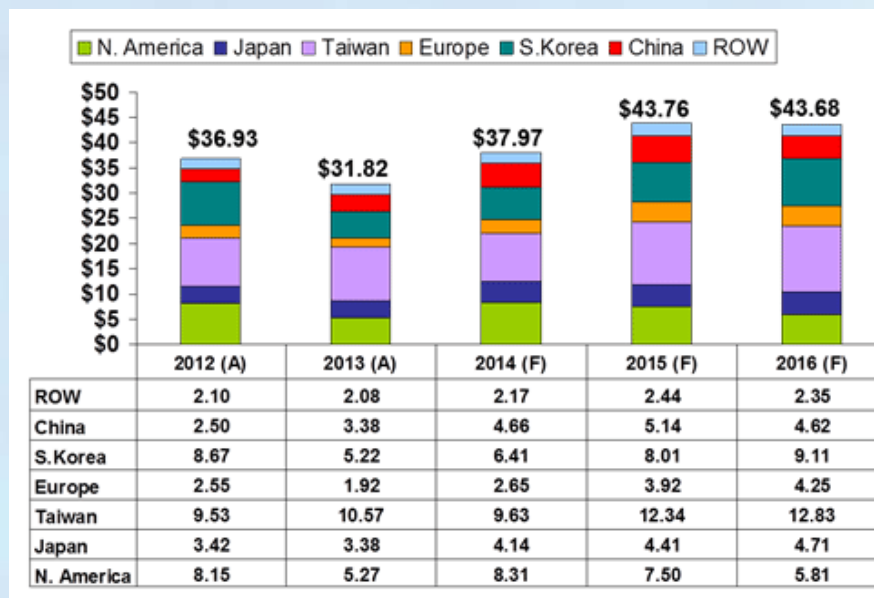
註2：係採用繼續營業單位稅後淨利及當期期末股數計算之EPS

全球半導體廠資本支出 (單位=USD Million)



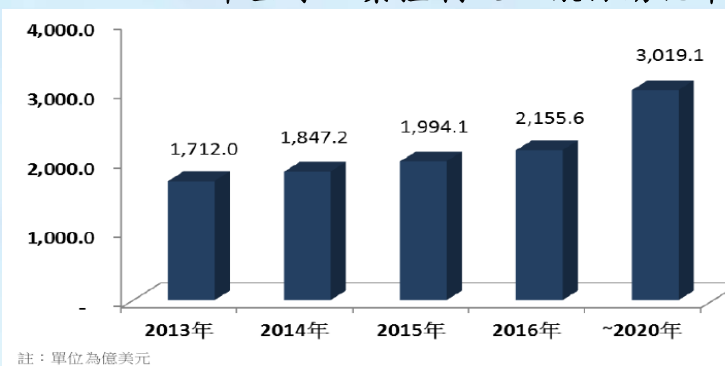
資料來源：IC Insight, 本公司整理

2012~2016年全球半導體設備市場預估



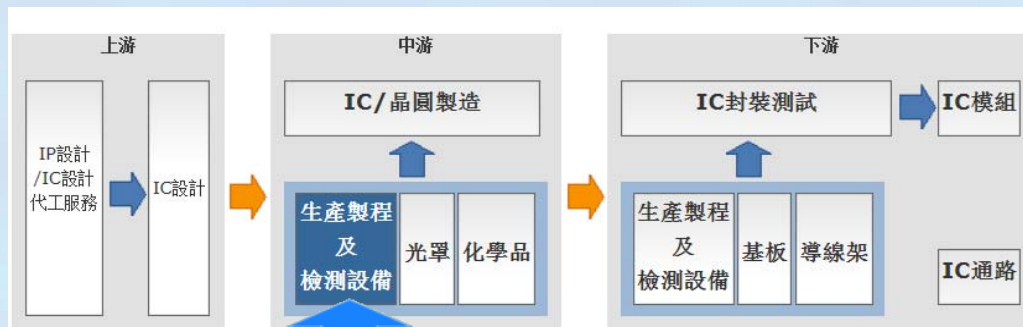
資料來源：SEMI，2014年12月

2013~2020年全球工業控制及工廠自動化市場規模趨勢



資料來源：工研院IEK，2014年11月

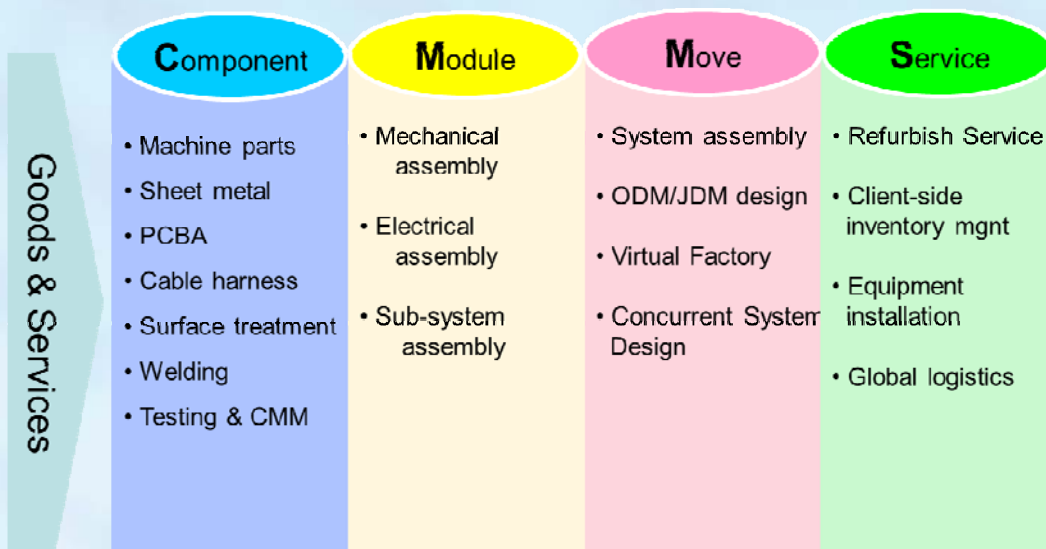
半導體產業鏈



京鼎深耕專注於半導體前段製程設備 +
垂直整合全方位製造

自動化系統整合整廠輸出

工業自動化之階層架構



- 公司研發技術團隊積極提升半導體設備生產技術，以精密製造及系統垂直整合技術能力，通過國際半導體設備知名大廠製程及產品的認證，並於2013年獲得全球第一大半導體設備廠—A公司公佈為其全球品質及交期最優秀的供應商。
- 獲得美國A公司 2013年最佳品質及準時達交供應商評鑑獎 (2013 Supplier Performance Award) 排名領先 Flextronics and Sanmina 和其他歐美日及新加坡大廠。
- 在自動化設備的設計上，公司長期掌握關鍵製程技術，整合光機電及軟體研發創新，觸角已伸至觸控面板、半導體、太陽能及機器視覺檢測等產業。未來將跨足更廣泛的應用領域，如能源、環保及醫療設備等，以多角化經營的理念，降低在設備製造市場的激烈競爭環境下被取代的風險。



**以半導體設備製造能力為基石, 機、光、電、軟工程技術為支柱,
建構先進設備研發製造的領先優勢**



業界領先的半導體設備垂直整合製造能力

- 14年半導體前段製程設備製造經驗, 建立垂直整合製造能力, 強化成本、交期、品質主控權及領導地位



完善的工程設計、生產製造、品質及供應鏈管理系統

- 與全球第一大半導體設備商長期合作, 建立完整製造及研發管理體系



擁有關鍵製造技術且獲得專業製程認證

- 透過半導體級表面處理、大型精密加工及焊接關鍵技術的掌握及認證要求, 構築高進入門檻



半導體廠自動化及高潔淨度設備技術

- 10年以上半導體設備開發經驗, 在半導體廠自動化系統開發、微污染防制等領域具有豐富實績



光學、機械、電控、軟體、製程跨領域研發及整合能力

- 深耕雷射製程設備及自動光學檢查設備, 能就近提供國內面板與光電廠國際級品質水準的優質產品及服務



全廠自動化系統整合及整廠輸出技術能力

- 透過垂直整合及高度自製率, 提供客戶客製化的整廠規劃服務, 創造富有競爭力、一站購足之完整解決方案

面板設備

- 自動化搬送系統
- 強化玻璃雷射切割設備
- 製程設備製造

半導體設備

- 製程設備製造
- 檢測設備製造
- 自動化標準介面設備

以精密零組件製造力為基礎，搭配機、電、軟、光等設備研發技術力，研發高端先進設備，朝向科技服務專業公司發展。

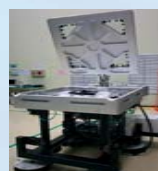
環安及醫療設備

- 以精密製造及研發設計能力為基礎，跨入環安及醫療設備產業，成為京鼎再成長動力。

跨產業自動化整合

- 人工視覺應用
- CIM整合
- 整廠自動化設備
- 太陽能模組自動化生產線

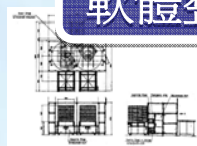
製造面



真空腔體製造及組裝測試技術

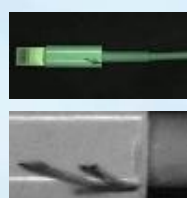
真空及高潔淨度關鍵零組件製造

自動化機電軟體整合



半導體前段製程設備整機垂直整合一條龍生產

機電、光學、視覺演算法整合



大型精密真空腔體及整機設備製造測試

先進雷射製程及自動光學檢測技術開發



半導體及面板設備及整廠智能自動化技術開發



智慧醫療及環安設備製造及開發

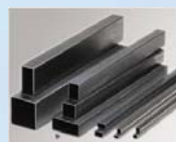


設計面

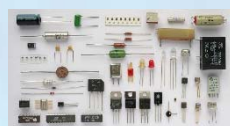
原材料



鋁材



鋼材



電子元件

市購標準零件



控制器



控制器



感測器



感測器



真空泵及馬達



真空泵及馬達

加工



機械加工



板金加工



SMT

零件半成品



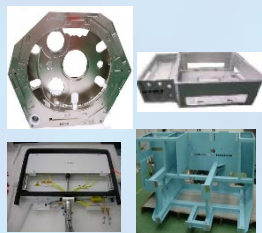
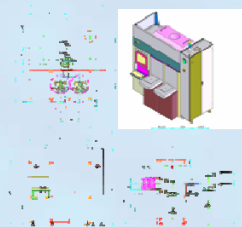
設備產品



主要模組



設備整機



產品開發與工程分析

- 產品規格制定
- 設計研發
- 製造工程展開
- 製造標準訂定
- 檢驗標準訂定

零件製造及小型模組生產

- 金屬元件製程
- 高分子材料元件製程
- 精密焊接製程
- 表面處理製程
- 電路元件製程

次系統模組整合製造

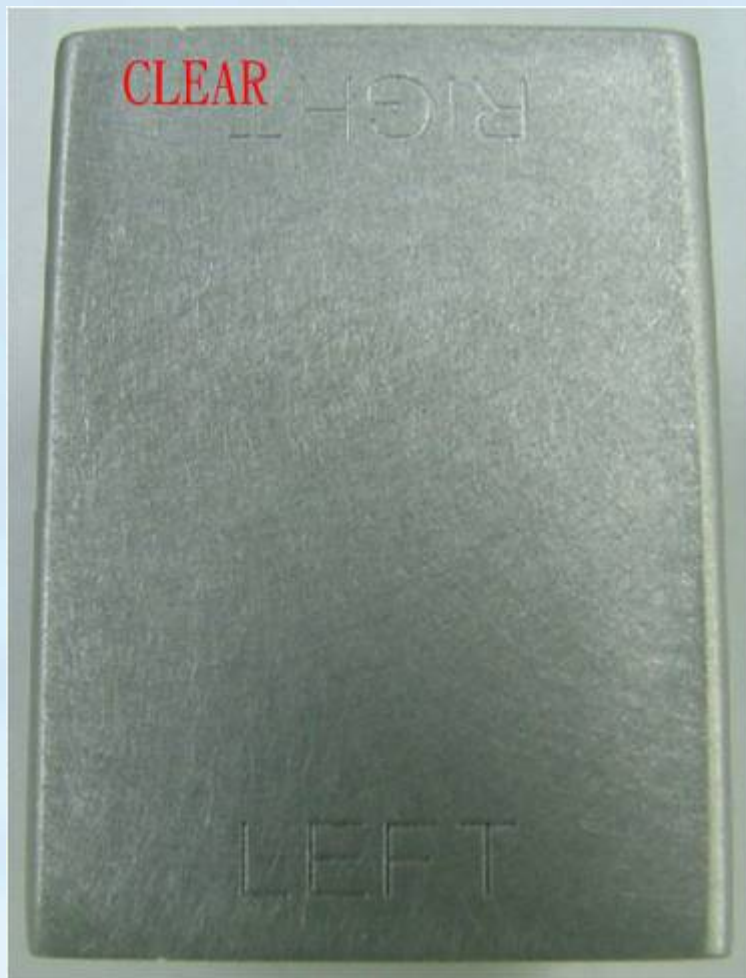
- 主幹配線
- 機架組裝
- 製程核心組裝
- 標準零組件安裝
- 製程核心測試/真空測漏

整機系統整合

- 系統規劃
- 標準流程訂定
- 各次系統模組整合
- 整機系統整合
- 外觀及週邊設施整合

系統最終測試與調校

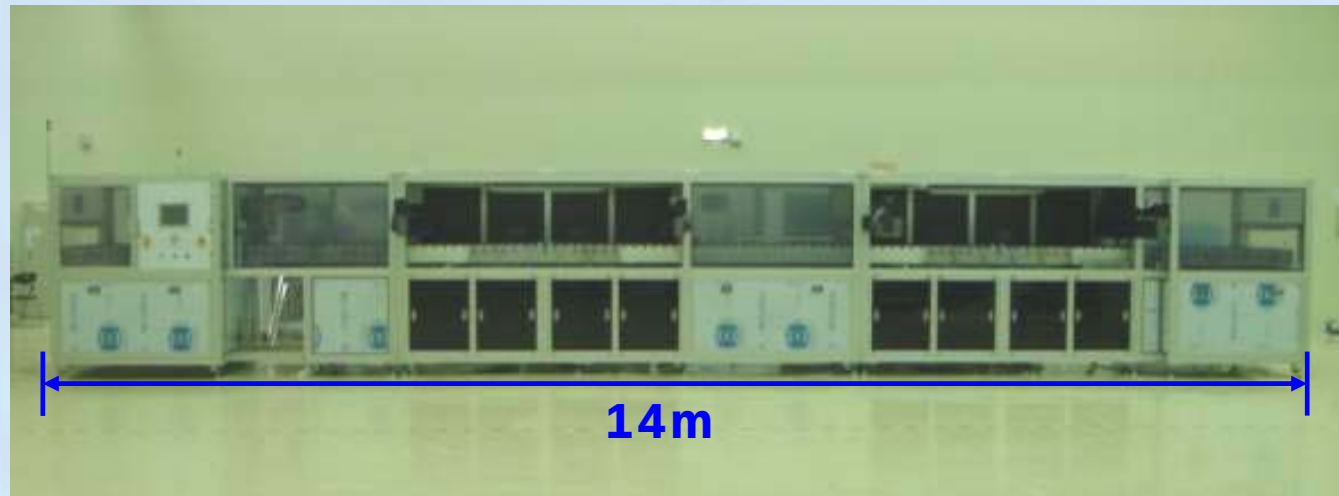
- 測試標準流程規劃
- 建立標準測試治具及環境
- 系統測試
- 製程測試
- 外觀檢查



Blue



- 8.5代面板廠傳輸自動線



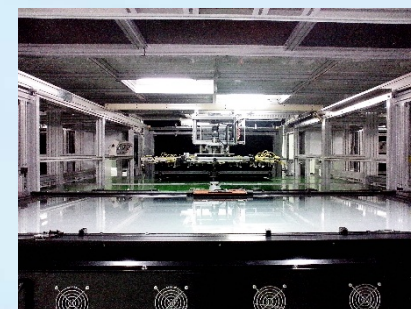
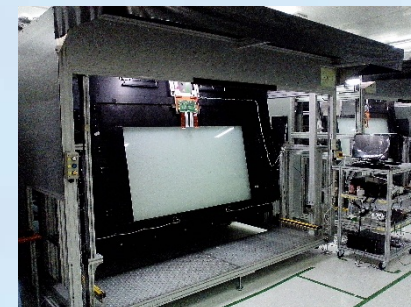
- 面板自動傳輸搬送系統



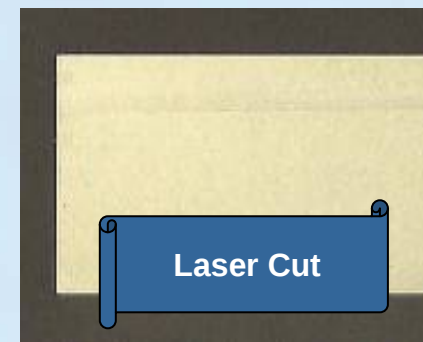
- 面板探針檢查設備



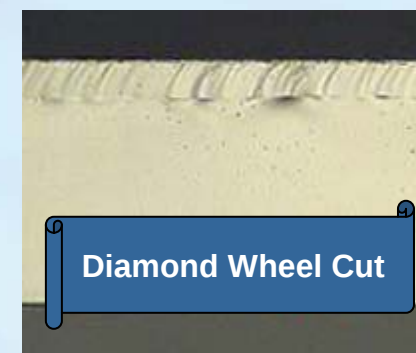
- 80吋電視面板點燈檢查線



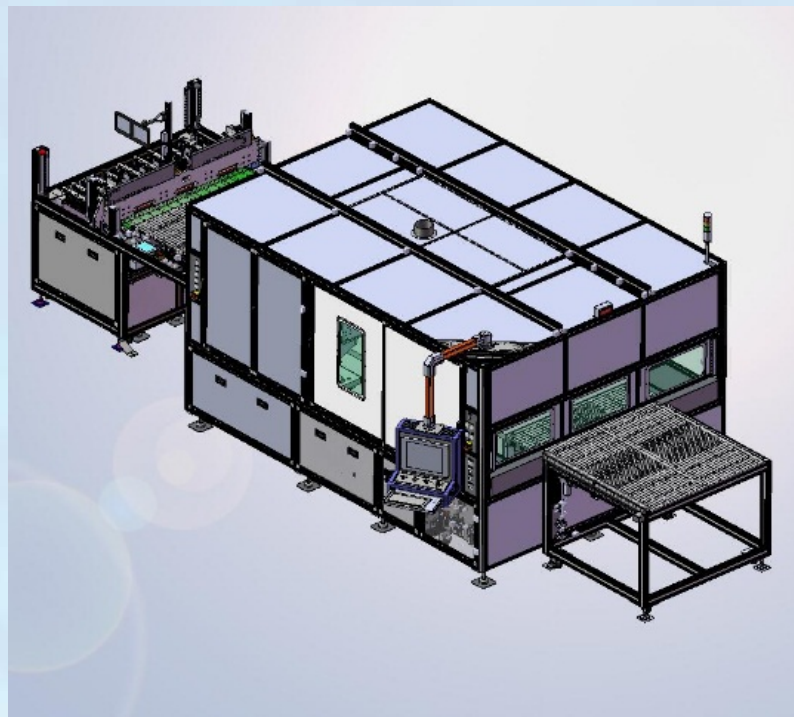
- 第4.5代觸控面板強化玻璃雷射切割設備



VS.

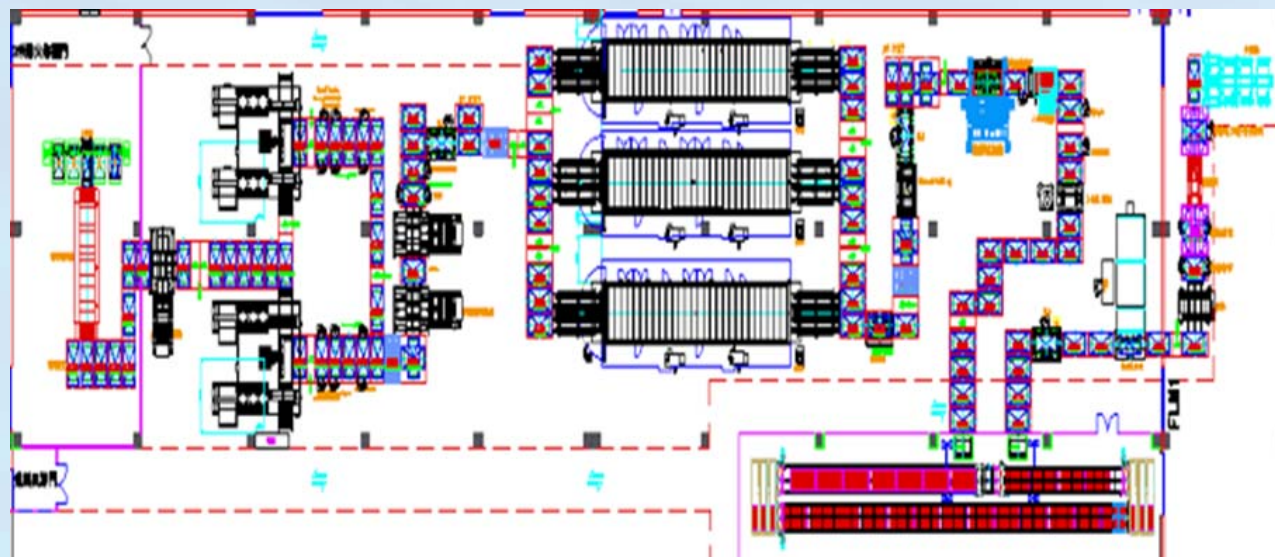


- 第5代連線式觸控面板強化玻璃雷射切割設備



- 觸控玻璃自動排版貼合設備





Auto-Bussing Machine



Auto-Trimming Machine



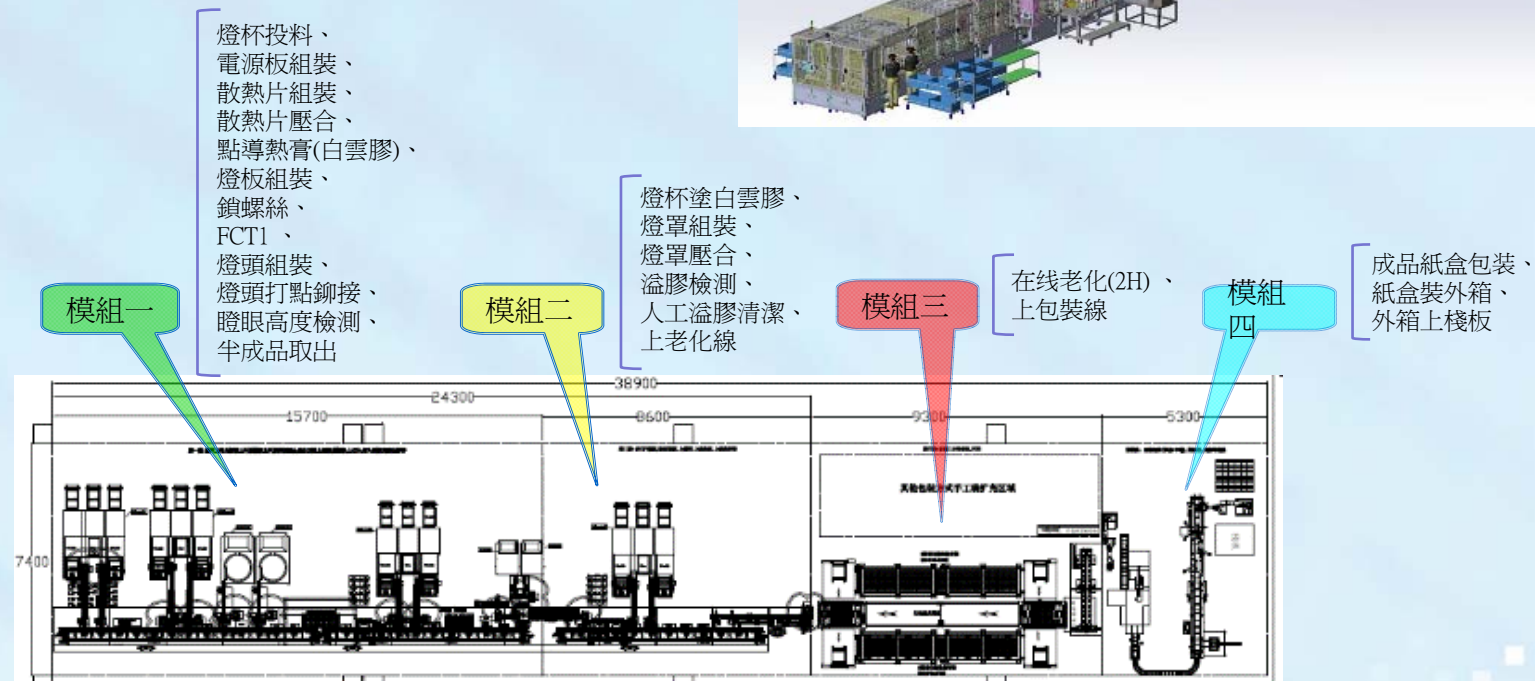
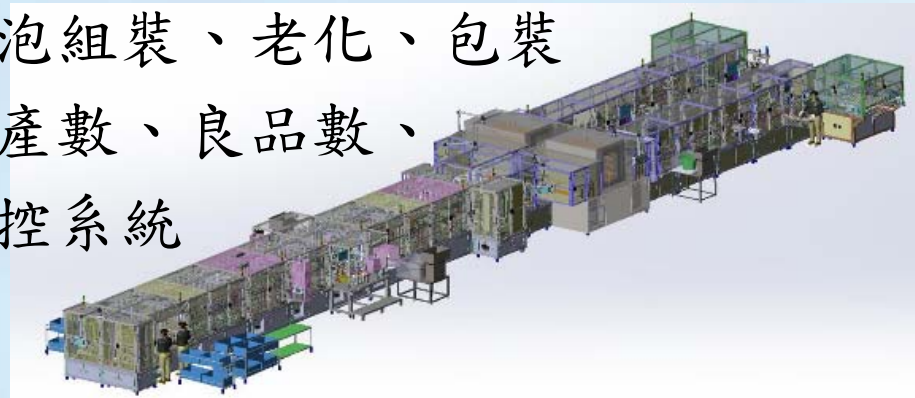
Auto-Framing Machine



Junction Box Assembly Machine

- LED燈泡全自動組裝線 (G5)

- G5 UPH比G4之1500pcs/h 增加200%，達到3000pcs/h
- 整線功能高度集成化，含燈泡組裝、老化、包裝
- 生產監控智能化，各工站生產數、良品數、機故時間數據實時上傳中央監控系統



- LED燈泡全自動組裝線 (G1)





Power Distribution System

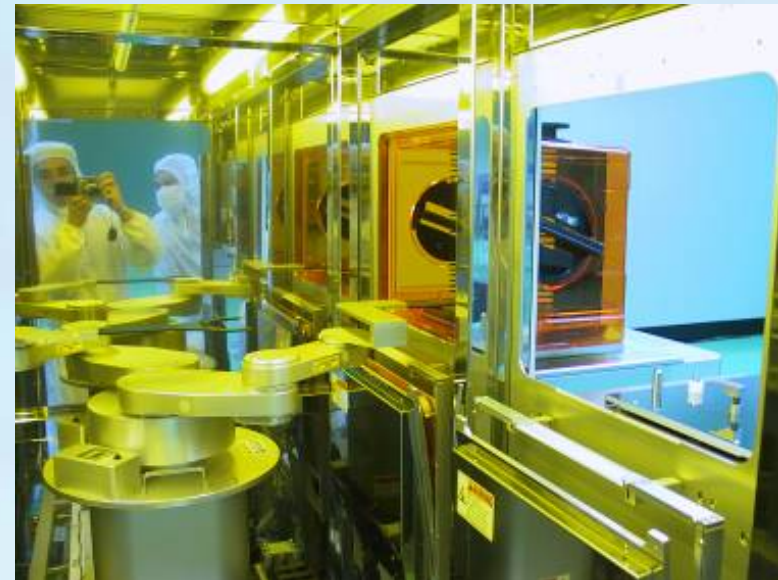


Transformer
Rack

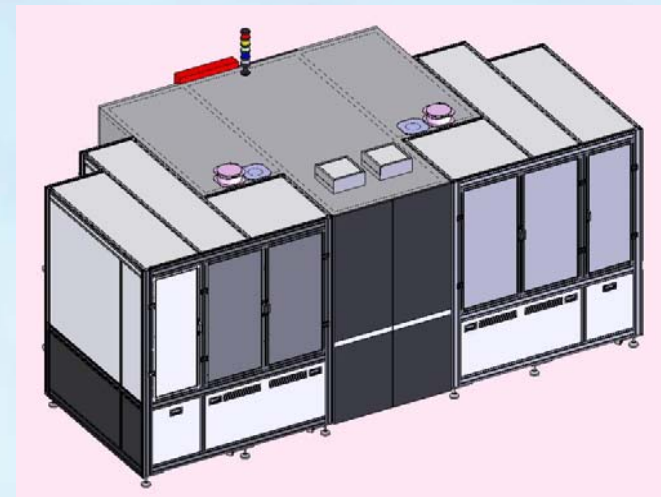
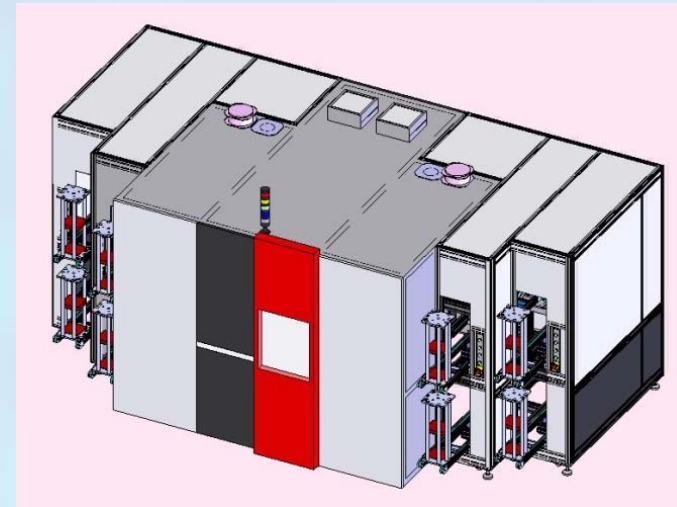


Equipment Rack

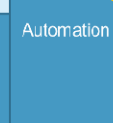
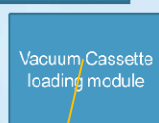
- 12吋晶圓自動裝載設備(EFEM)



- 太陽能雷射製程自動化晶片與卡匣傳輸儲存設備



- 太陽能鍍膜製程自動化晶片與卡匣傳輸儲存設備
 - 可對應單晶與多晶156mm太陽能晶片（厚度 $>140\mu\text{m}$ ）
 - 搭接PECVD製程，成為in-line全自動鍍膜設備
 - 多層卡匣儲存區達半小時以上供應（最多4層，160卡匣）
 - 傳片速度達每小時5600 pcs
 - 機構傳輸良率 99.9%



99年度

- In-line多站式奈米碳管薄膜貼膜機開發完成及接單量產
- In-line多片式NCVM真空蒸鍍機
- 開發完成雷射切割機對應高強化鈉鈣玻璃切割製程，並通過國內觸控面板大廠驗證並下單
- 開發完成鋰電池生產自動化設備並接單量產
- 對應第三代LED燈泡之全自動生產線

100年度

- 開發完成新一代OGS單片式觸控面板專用超高強化玻璃切割製程，設備通過國內觸控面板大廠驗證並下單
- 與德國太陽能設備大廠合作，開發先進太陽能電池製程之自動化設備
- 開發太陽能模組自動生產線

101年度

- 超高強化觸控面板玻璃雷射切割機
- 大型電視模組半自動生產線
- 太陽能模組無人化全自動生產線

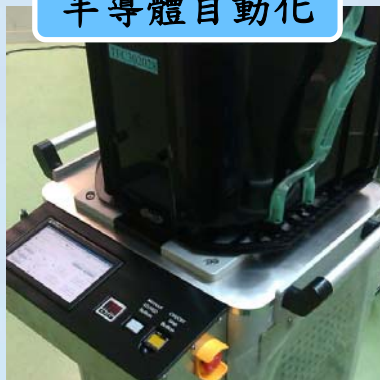
102年度

- 20奈米半導體先進製程高潔淨氣體自動充填設備
- 觸控面板大世代連線式雷射切割機
- 大型電視模組自動生產線
- 機器視覺檢測貼合設備
- 表面玻璃成型自動化設備

103年度

- 開發16奈米先進製程微污染防制自動化設備
- 開發觸控面板異型雷射切割機(持續進行中)
- 開發大型LED燈具全自動生產線

半導體自動化



對應先進半導體製程之
微污染防制設備

太陽能自動化



先進太陽能電池製程之
自動化設備

面板檢測



顯示器面板
自動光學檢測設備

全廠自動化



第五代LED燈泡全自動
鉅量產生產線

醫療照護



開發智慧醫療及
健康照護相關產品

環安監控



廢水處理廠自動化控制系統

短期發展計畫

1. 擴大精密設備產品組合，跨足不同產業。
2. 選擇各產業的領導者做為合作夥伴。
3. 與客戶建立緊密的策略聯盟關係。
4. 以服務為導向，第一時間反應、處理並滿足客戶的需求。

長期發展計畫

1. 積極爭取與不同產業大廠合作，成為世界級半導體及設備專業技術服務者。
2. 積極爭取跨入新興產業，如：醫療設備及環保設備。
3. 整合海內外生產基地，以提升公司競爭力。
4. 透過垂直整合及強化本地供應商之國際競爭力，為客戶提供完整設備製造及相關需求平臺。

Thanks for Your Attention

Q & A